

平成30年 8月 1日

NEDIA会員各位

(一社)日本電子デバイス産業協会
事務局次長 小林関司

材料部品部会主催・第二十回勉強会開催のご案内

盛夏の候、皆様にはご健勝のこととお喜び申し上げます。

下記の日程で「第二十回材料部品部会主催の勉強会」を開催いたします。

今回の勉強会では、電子デバイス産業関連の最新動向、技術動向についての講演をしていただく予定です。

是非大勢の方のご参加をお待ちしております。

—記—

1. 日時 平成30年9月13日(水)(13:00~16:30)

2. 場所 御茶ノ水めっきセンター4F会議室

東京都文京区湯島1-11-10

03-3814-5621(代)

<http://www.tmk.or.jp/gaiyou.html>

3. 講演スケジュール

(1)(13:00~13:40)

テーマ「半導体パッケージング技術の推移と将来!!」

~~QFNの重要性と製造技術から見える~~

講師 加藤 凡典氏 / AiT 代表取締役

(2)(13:40~14:10)

テーマ「戦略マップ 2018-2019」

講師 松本哲郎氏 / Z2A企画

(3)(14:10~15:00)

テーマ「ウエハ・パネルレベルパッケージング向けガラスの開発とその特徴」

講師 林 和孝 氏 / ASG株式会社 商品開発研究所 主幹研究員

休憩時間 (15:00~15:15)

(4)(15:15~16:30)

テーマ「AI、IoT、クラウド、5Gの最新動向と半導体」

講師 津田建二氏 / (株)セミコンダクタポータル 編集長

(注) 添付の用紙に出欠を記入の上、9月 6日までにメールにて事務局宛に返信をお願い致します。

以上